

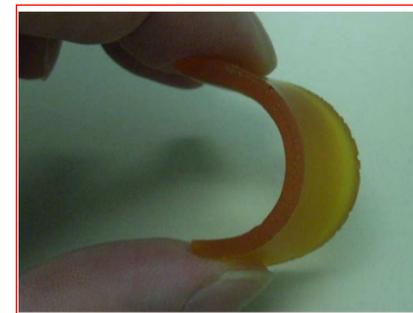
# 「2022 マイクロエレクトロニクスショー」に 当社の高機能接着材料を出展します



2022年6月15日(水)～17日(金)に東京ビックサイトで開催される  
[「2022 マイクロエレクトロニクスショー」](#)に当社の高機能接着材料を出展します。  
半導体実装で培った接合技術をベースに、短時間硬化、低弾性高密着など、お客様のご要望に合わせた高機能な接着材料を開発し、ご提供しております。  
ご来場の際は、是非お立ち寄りください。

- ・小間番号：東展示棟 4A-13
- ・出展ゾーン：eX-tech

## 【出展材料】



超短時間硬化接着剤	わずか3秒で完全硬化
低弾性高密着強度接着剤	シリコン並の柔らかさで、かつ、エポキシ並の高強度な材料
接着剤補強型Sn-Biはんだペースト	180℃以下接合可能で、SACはんだと同等以上の特性
一液低温短時間硬化接着剤	70℃での低温短時間硬化ながら、常温で5日間大きな粘度変化しない